

半導體設備 人才實務訓練班

開課期間：115/05/04-115/05/31

經濟部產業發展署半導體國際連結創新賦能計畫/南亞科技半導體設備人才專班

- 跨域人才** 歡迎無半導體相關經驗人才報名、理工相關科系尤佳
- 實作體驗** 課程安排半導體類產線參訪，實際體驗工程師的工作內容
- 就業接軌** 訓前參與南亞科技半導體設備工程師職缺面談，通過面談並完成課程結訓，立即就業

南亞科 薪酬介紹

1. 全年月薪至少超過 15 個月
 2. 三節獎金\$6,500*3，起薪45,000元起 (理工相關科系)，另有輪班獎金7,000元起
 3. 特殊節慶另提供不定額禮券或慶祝活動 (生日、過年、勞動節、端午節、中秋節)
 4. 變動性薪酬獎金 (員工分紅、激勵獎金、員工認股權)
- *另有伙食、住、行、育兒、娛樂、健康各項福利，詳細資訊歡迎報名加入本訓練班洽詢

報名流程



招生對象

1. 大專以上畢業
2. 無半導體相關經驗人才亦可、理工相關科系尤佳
3. 對參與AI伺服器供應鏈製造生態系有興趣者

洽詢窗口

資展國際 半導體人才培訓專案辦公室 聶小姐
02-66316582/02-66316591
lucynieh@ispan.com.tw

上課地點

1. 資展國際
台北市復興南路一段390號2樓，近大安捷運站
2. 龍華科技大學 (半導體類產線)
桃園市龜山區萬壽路一段300號

課程費用

全期課程免費



報名連結